

宁波康强电子股份有限公司

关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架

生产线项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资项目概述

宁波康强电子股份有限公司（下称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过《关于投资建设高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目的议案》，为进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行业发展市场机遇，扩大公司产品市场占有率，董事会同意公司投资 10 亿元建设年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。

该投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。为确保本项目能顺利实施，董事会授权公司管理层在上述额度内办理投资建设生产线的全部事宜，包括但不限于新建厂房及配套设施、购买机器设备以及办理其他与本投资事项相关的一切事宜。按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资事项需获得股东会的批准。

二、投资项目基本情况

- 项目名称：年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目。
- 项目投资规模：项目投资规模约 10 亿元，最终投资总额以实际投资为准。
- 项目建设内容：本项目利用公司宁波厂区西厂区原有土地 46427.51 平方米，新建 4 栋车间及 1 栋办公楼、1 栋宿舍楼，总建筑面积约 124984 平方米，新购置生产及测试设备 991 台（套），建设高密度蚀刻引线框架和高精密冲压引线框架生产线。
- 项目建设期：项目分两期建设完成，其中一期高密度蚀刻引线框架产能

1200 亿只预计 2029 年 12 月投产，二期高精密冲压引线框架产能 300 亿只预计 2032 年 12 月投产，最终以实际建设情况为准。

5、项目资金来源：自有资金和银行贷款。

三、投资项目的可行性和必要性分析

1、把握人工智能、智能网联汽车等产业发展风口的必然选择。5G、人工智能（AI）、物联网等先进技术的普及对半导体器件的精密性、小型化、高性能提出更高要求，进而催生对具备更优的热性能、电性能及小型化适配能力高端封装材料的需求。

2、提升半导体封装测试材料自主化水平的重要举措。全球主要引线框架厂商正加快全球布局，提升产能，深化本地化服务，并通过并购整合和战略合作强化市场地位。本项目的建设实施将新增高性能蚀刻引线框架产能 1200 亿只，进一步打破高端集成电路封装用蚀刻引线框架长期以来被国外公司垄断的局面，提升我国半导体封装测试产业链供应链韧性和自主发展水平。

3、巩固提升企业竞争优势的迫切需求。公司拥有先进的半导体封装材料引线框架及键合丝生产技术，多年来致力于技术创新、工艺创新和管理创新，将研发与市场需求相结合。建成拥有自主知识产权并可批量生产高密度蚀刻集成电路引线框架示范工程生产线，为高端封装材料的研究开发创造了良好基础条件，打破高端集成电路封装用蚀刻引线框架长期以来被国外公司垄断的局面。

四、投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

公司多年来一直从事各类引线框架、键合丝等半导体封装基础材料研发生产，拥有多项自主知识产权专利技术和技术攻关成果。随着公司品牌知名度的提高，产品竞争力和市场开拓能力进一步提升，现有的生产能力已无法匹配业务发展和技术产业发展趋势。为进一步把握全球人工智能、智能制造以及半导体行业发展市场机遇，扩大公司产品市场占有率，公司决定依托现有销售体系和技术研发能力，在现有生产厂区西侧的厂区内新建年产 1500 亿只高密度高可靠性集成电路引线框架生产线项目，本项目实施为企业抢占高端引线框架市场提供有力支撑。

2、对公司的影响

本次投资的资金来源为自有资金、自筹资金，鉴于项目存在一定建设周期，本次投资不会对公司当前财务状况及经营成果构成重大不利影响。

五、风险提示

1、本次投资项目的实施，尚需办理项目部分前置审批工作，如因国家或地方有关政策调整，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险。

2、本次项目在具体实施过程中或存在市场环境变化、产业政策调整等不可预知的风险，对公司未来年度经营业绩的影响需根据具体项目的推进和实施情况而定，对公司目前经营业绩不构成重大影响。

3、本次投资事项尚需提交公司股东会审议，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照相关法律法规的要求，履行必要的审批程序和信息披露义务。

六、备查文件

公司第八届董事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

2026年3月30日